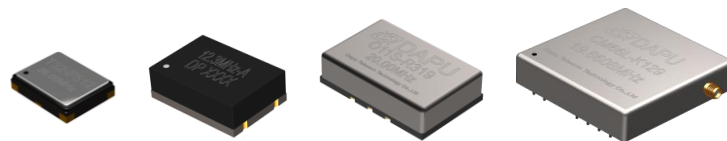




O23B-L446-100.00MHz分析报告




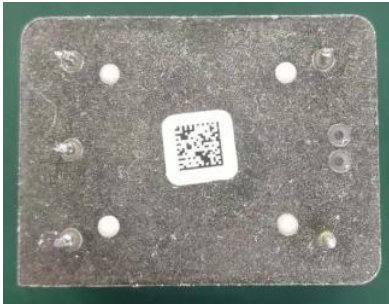

Sync with you!

问题描述



问题描述：

2019年11月21日，收到客户反馈我司出货的O23B-L446-100.00MHz产品，在客户端频综失锁，能发热无输出1pcs；

编号	外壳	底板	侧面
#1			

常规指标复测



查询产品的出货测试记录，此产品是2013年2月1日出货，出货测试数据显示所有测试项均合格，符合规格书要求；
对退回产品复测常温下性能指标，产品频率输出和其他指标合格；
产品复测数据如下：

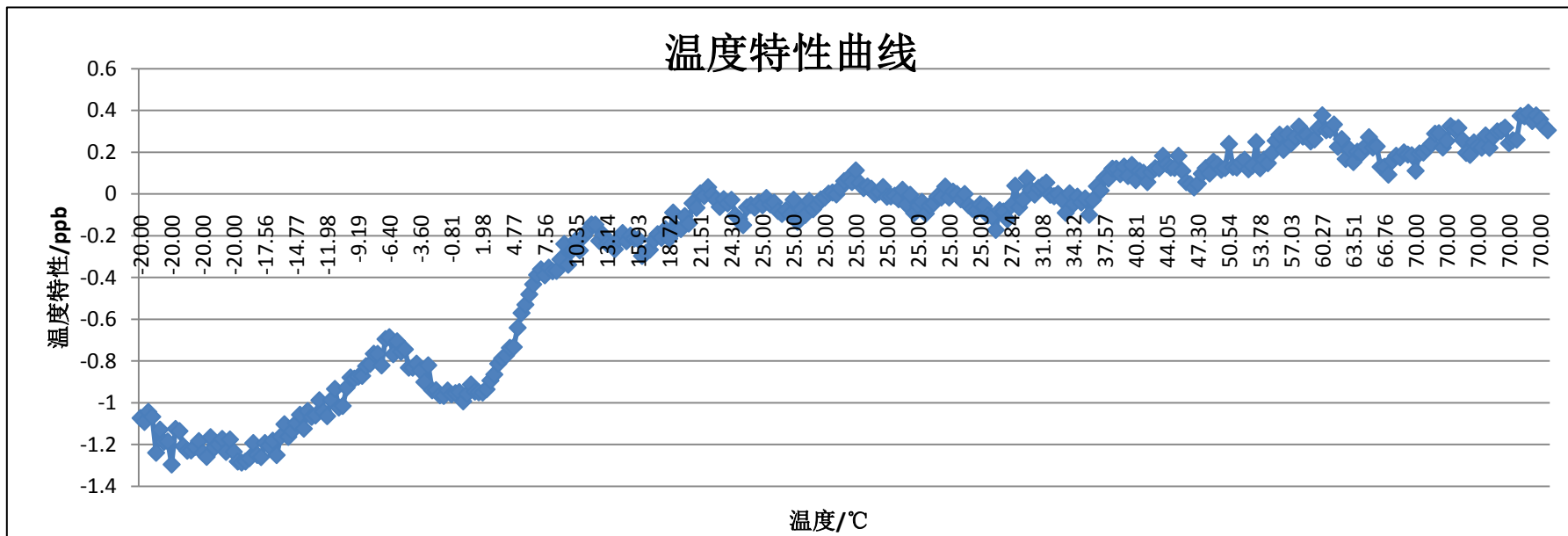
产品编号	分类	频率精确度	工作电流	启动电流	阻抗	幅度	波形	结果
		$\leq \pm 0.5\text{ppm}$	$\leq 200\text{mA}$	$\leq 400\text{mA}$	$\geq 100\text{K}\Omega$	6dBm~10dBm		
1#	出货数据	0.03	153.00	394.00	214.00	7.27	Sine wave	合格
	11月21日退 回复测数据	0.11	170.00	390.00	223.00	7.90	Sine wave	合格
	12月9日退回 复测数据	0.12	170.00	390.00	222.00	8.05	Sine wave	合格

综上所述，1#样品在出货前和退回复测各项指标测试符合规格书要求，测试合格；

温度特性复测

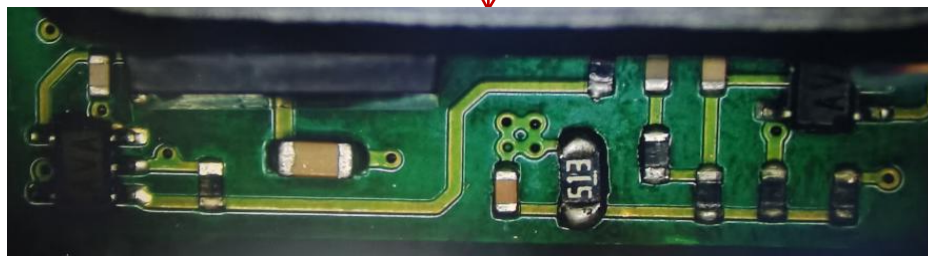
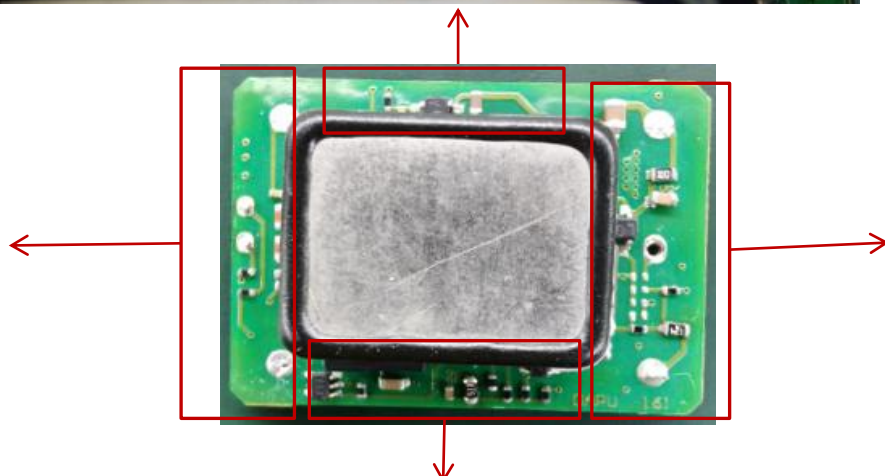
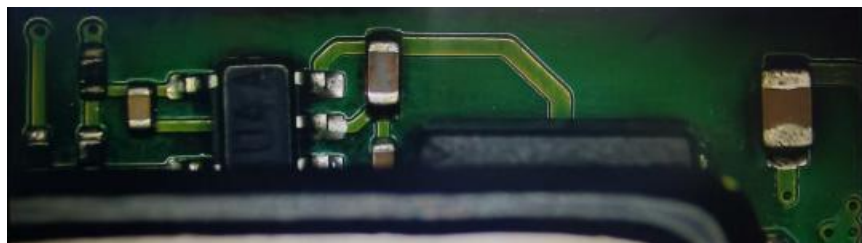
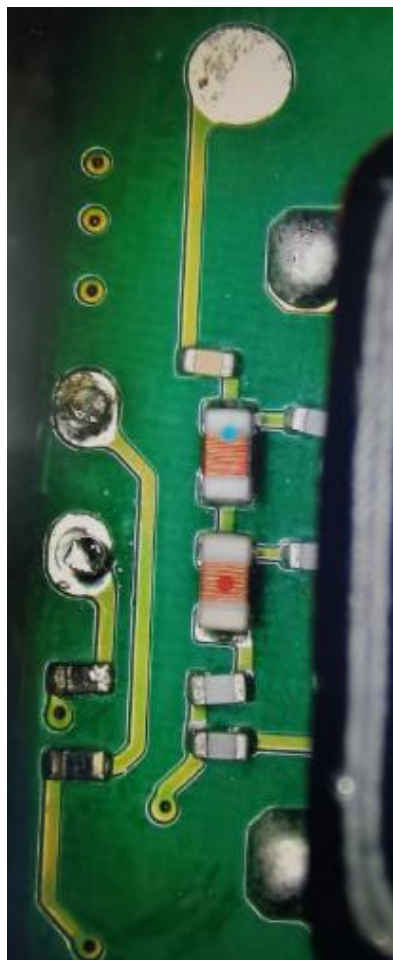


对#1样品进行温度特性测试，温度范围-20~70℃，经测试#1样品的温度特性曲线符合规格书要求的F (Abs) ≤5ppb。
温度特性测试曲线如下(单位：ppb)，如下图：



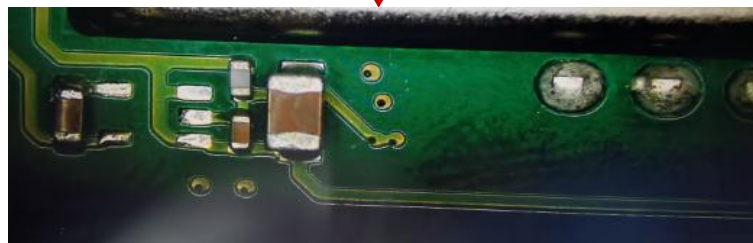
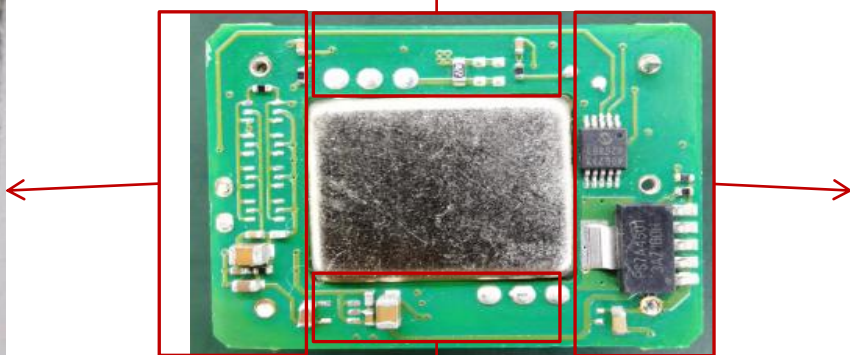
结论：1#样品频率输出正常、电流、阻抗、幅度、波形和温度特性均合格，满足规格书要求。

产品焊接检查-下板正面



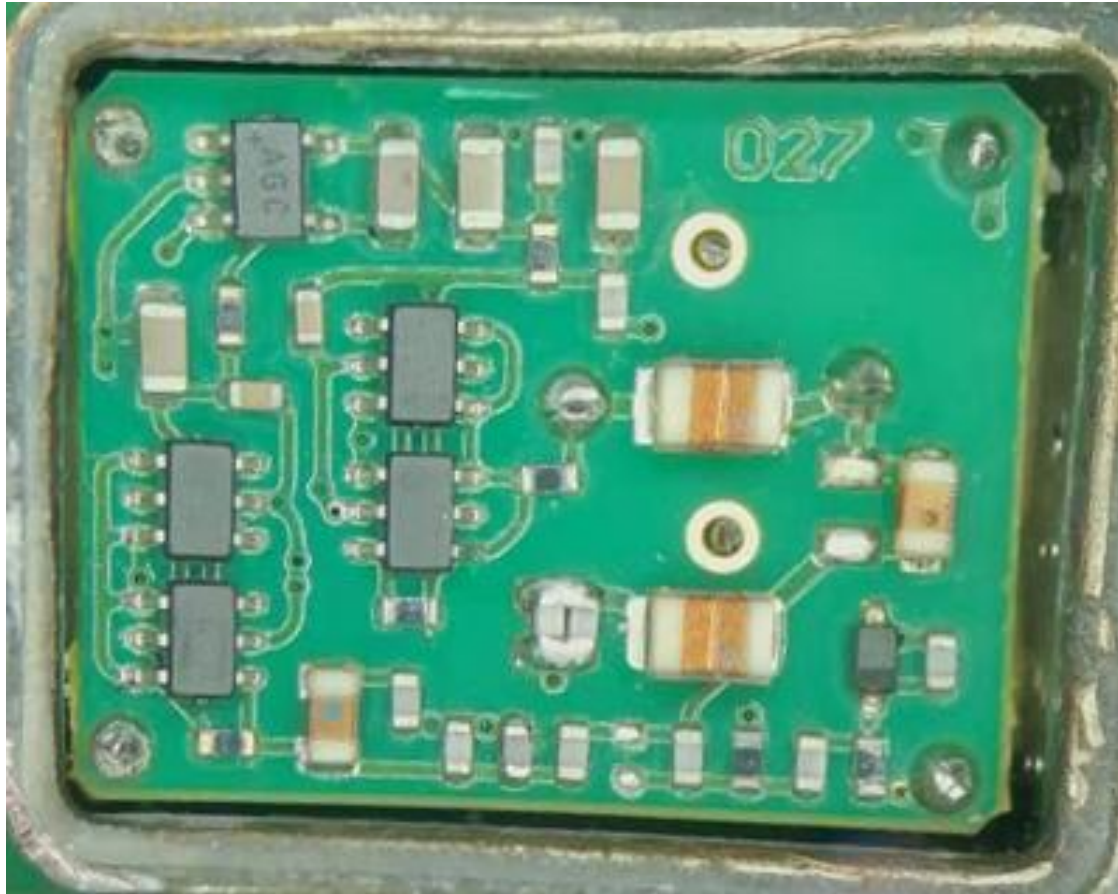
拆产品外壳，检查下板器件焊接质量，未发现虚焊现象；

产品焊接检查-下板反面



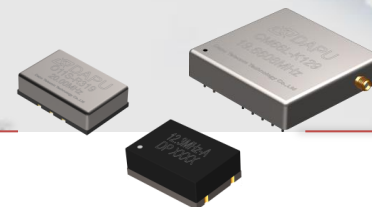
拆产品外壳，检查下板器件焊接质量，未发现虚焊现象；

产品焊接检查-上板



拆产品外壳，检查上板器件焊接质量，未发现虚焊现象；

总结



结论：

1#样品通过重新复测各项指标，频率输出正常、电流、阻抗、幅度、波形和温度特性均满足规格书要求，测试合格。为进一步分析，将产品拆壳后在40X显微镜下逐一检查各器件以及连接处焊点，未发现焊点存在明显虚焊、假焊等焊接不良现象，产品焊接质量合格。



Thanks!

